

H-putty

Thermal Conductive Putty

LiPOLYのH-putty シリーズは、熱伝導率：3.5 W/m*K の隙間充填材です。変形性が高く、隙間に合わせて上手く充填し、公差を補う特性も備えております。また、パティの逆流、乾かす等の問題もなく、熱がより良く伝導することができます。当社が開発のディスペンサーを使って、自動化生産ラインには適切な製品です。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率: 3.5 W/m*K
/ 対応可能薄さ: 100-3000μm
/ 公差を補われる特性
/ 精密部品には圧力をかけず
/ 垂れせず
/ バッチ生産可能
/ 高圧縮及び低応力環境には適合

■ 製品アプリケーション

/ CPUと放熱シンクの間隙
/ PCコンポーネントと放熱シンクの間隙
/ 高速記憶装置
/ 通信設備
/ フラットパネルディスプレイ
/ セットトップボックス
/ ネットワークカメラ
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 容量の単位

/ カートリッジ: 30ml, 55ml, 330ml
/ ペール缶: 1kg, 25kg

■ 保存期間

/ 当製品が未使用の状態
/ 室温25度の条件には60ヶ月
/ が保存できます。

■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	H-putty	TEST METHOD	UNIT
Color	Blue	Visual	-
Resin base	Silicone	-	-
Viscosity	15000	DIN 53018	Pa.s
Density	3.0	ASTM D792	g/cm³
Application temperature	-60~180	-	°C
Bond line thickness	100~3000	-	μm
Shelf life	60 months	-	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	12	ASTM D149	KV/mm
Volume resistivity	>10 ¹³	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal conductivity	3.5	ASTM D5470	W/m*K
Thermal impedance@10psi / 60°C	0.076	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@30psi / 60°C	0.072	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@50psi / 60°C	0.069	ASTM D5470	°C-in²/ W

■ 備考

全自動ホモジナイザーを使用する場合は沈降現象が急速に改善され、均質な効果が得られます。製品は沈降現象を起こらないように、使用する前に3 ~ 5 分間の均質化してください。
注意: 製品が均質化済みの状態で 24 時間以上未使用の場合、再び使用中に再度均質化する必要があります。

■ 垂れ落ち試験

3.0mmのシートを使って、隙間調整を行う。パティをアルミ板とガラス板の間に乗せて、試験前にはパティの位置を表記し、125°Cのオーブンに1000時間ベーキングした後を取り出して、パティの位置を再確認する。



高温試験終了後
材料は元の位置からずれるかを確認する